

NEU – der SMT-BLOG

Der **SMT-BLOG** wird künftig an prominenter Stelle auf unserer Webseite veröffentlicht und laufend ergänzt.

Jeder Fachbeitrag, der in der **SMT** erscheint, wird zusätzlich online im **SMT-BLOG** veröffentlicht, der dadurch zu einem Nachschlagwerk der Branche wird.

Zu jeder Anzeige, die in der Printausgabe der **SMT** gebucht wird, erhalten Sie **ohne Mehrkosten** eine **Banneranzeige** im Format 160 x 600 pixel mit einem von Ihnen gewählten Link zu Ihrer Website, so lange, bis eine neue Ausgabe erscheint.

Damit ist Ihre Werbung in der Printausgabe und auf unserer Homepage vertreten und wirkt zweifach.

Ihre Präsenz erhöht sich signifikant in Suchmaschinen.

Der **SMT-BLOG** hat bereits jetzt gute Zugriffszahlen und die Reichweite Ihrer Werbung wird kontinuierlich erweitert.

www.smt-verlag.de

SIE LESEN LIEBER DIGITAL?

DANN REGISTRIEREN SIE SICH EINFACH AUF UNSERER WEBSITE!

www.smt-verlag.de unter *onlineregistrierung*

Sie möchten die **SMT** bzw. die **emv-esd** oder die **CADS** in digitaler Form erhalten?

Dann registrieren Sie sich einfach auf unserer Website!

Eine E-Mail Adresse genügt und Sie erhalten zukünftig eine Nachricht bei Erscheinen einer neuen Ausgabe unserer Magazine.

Erhältlich ist das Heft im Format PDF, sodass die **SMT** auf jedem digitalen Endgerät gelesen werden kann.

Registrieren Sie sich gleich jetzt auf unserer Website: www.smt-verlag.de unter *onlineregistrierung*

PS: Ihre Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben



Redaktion + Vertrieb

Dipl.-Ing. (FH) Jost Dennier
info@smt-verlag.de
www.smt-verlag.de

Oberer Schenkgarten 1
55218 Ingelheim
Tel: +49 (0)6132 4316-47
Fax: +49 (0)6132 4316-49

Anzeigenverkauf

Johann Bylek
Tel: +43-660-224-7005
E-mail: bylek.johann@gmail.com

MEDIADATEN 2023

THEMEN
TERMINE
PREISE

Fachzeitschrift für Advanced Packaging & Elektronikfertigung

SMT

emv-esd

FACHZEITSCHRIFT FÜR ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT & AUSWIRKUNG ELEKTROSTATISCHER AUFLADUNG

CADS

CAE/CAD/CAM/CAQ

SMT | FACHZEITSCHRIFT FÜR ADVANCED PACKAGING & ELEKTRONIKFERTIGUNG

JAHRGANG 35
OKTOBER 2022
WWW.SMT-VERLAG.DE
30974

10 **SMT** + **CADS** 3

SMT SMART SHOPFLOOR MANAGEMENT SUITE WORKS VON ASMPT

Klebstoffe im Metall- und Leichtbau	Marktübersicht Bestückssysteme	Lifecycle Management	Künstliche Intelligenz und Machine Vision
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------	---

ASMPT

■ Herausgeber:	Jost Dennier	
■ Redaktion:	Dipl.-Ing. (FH) Jost Dennier	
■ Anschrift:	Redaktion SMT/CADS/EMV-ESD Oberer Schenkgarten 1 55218 Ingelheim Tel.: +49 (0)6132 43 16 47 Fax: +49 (0)6132 43 16 49 E-Mail: info@smt-verlag.de Web: www.smt-verlag.de	
■ Anzeigen:	Johann Bylek Telefon: +43-660-224-7005 E-Mail: bylek.johann@gmail.com	
■ Inhaber:	Jost Dennier	
■ Verlag:	SMT-VERLAG Oberer Schenkgarten 1 55218 Ingelheim	
■ Jahrgang:	36. Jahrgang 2023	
■ Erscheinungsweise:	6 x in 2023	
■ Erscheinungs-/Redaktionsplan:	siehe Seite 5/6	
■ Bezugspreise:	Jahresabonnement:	58,00 Euro inkl. Versand
	Einzelheft:	9,00 Euro
	Jahresabo: EMV-ESD bzw. CADS	29,00 Euro inkl. Versand

■ **Kurzcharakteristiken:**

»SMT Germany« ist die Fachzeitschrift für alle Bereiche der Elektronik-Fertigung und des Advanced Packaging.

Schwerpunkte sind:

Baugruppenfertigung, Leiterplattenfertigung, Halbleiterfertigung sowie Test und Qualitätssicherung. Ergänzt werden diese Themen durch Marktübersichten zu den wichtigsten Produkten und Dienstleistungen für die Elektronik-Fertigung.

»CADS« als Supplement von SMT Germany informiert über die Bereiche Entwicklung und Konstruktion in der Elektronik. Redaktioneller Schwerpunkt ist die Design-Automation bei der Anwendung von CA-Techniken wie Verifikation, Design, Routing, Signalintegrität u. s. w.

»EMV-ESD« ist das kompetente Fachforum für alle Fragen der elektromagnetischen Verträglichkeit und der Auswirkung elektrostatischer Aufladung sowie der messtechnischen Erfassung dieser Erscheinungen.

Zielgruppen sind Fachleute in den Bereichen Konstruktion, Fertigung und Qualitätssicherung in der Elektronik- und Halbleiterindustrie sowie in anderen Industriebereichen, die Elektronik in ihren Erzeugnissen einsetzen.

- **Auflagen-Analyse:** Intern (30.09.2021 -01.10.2022)
- **Druckauflage:** 8600
- **Tatsächlich verbreitete Auflage**
im Jahresdurchschnitt: 8374
- **Verkaufte Auflage:** 390
- **Freistücke:** 7759 pro Ausgabe
- **Rest-, Archiv- und Belegexemplare:** 220 pro Ausgabe
- **Tatsächlich verbreitete Auflage Onlineversand:** 420

■ **Geographische Verbreitungsanalyse**

Wirtschaftsraum		Anteil an der Auflage in %
Inland		
Postleitzahl 0	196	2,3
Postleitzahl 1	287	3,4
Postleitzahl 2	494	5,9
Postleitzahl 3	621	7,4
Postleitzahl 4	594	7,1
Postleitzahl 5	664	7,9
Postleitzahl 6	1024	12,2
Postleitzahl 7	1826	21,8
Postleitzahl 8	1445	17,3
Postleitzahl 9	759	9,1
Ausland		
Schweiz	111	1,3
Österreich	100	1,2
Großbritannien	66	0,8
Niederlande	84	1,0
Sonstiges Ausland	103	1,1
Gesamtauflage	8374	100,0

Branchen-/Wirtschaftszweige

Nr. Grundsystematik	Empfängergruppen	Exemplare	%
242	Maschinenbau	579	6,9
243	Datenverarbeitung/ Büromaschinen	116	1,4
244	Fahrzeugbau	206	2,5
248	Luft- und Raumfahrt	247	3,0
250	Elektronikfertigung	3453	41,2
	Unterhaltungselektronik	134	1,6
	Medizin techn. / Optik	291	3,5
	Leiterplattenhersteller	196	2,3
	Ing. Büros/Dienstleistung	1105	13,2
	Mess- und Regeltechnik	372	4,4
5	Nachrichtentechnik / Verkehr	746	8,9
	Bauelemente-Hersteller	232	2,8
	Stromerzeugung	64	0,8
9	Ausbildung / Forschung	575	6,9
	Sonstige Branchen	61	0,7
Tatsächlich verbreitete Auflage		8374	100,0

Betriebsgröße

	Exemplare	%
1 bis 9 Beschäftigte	1362	16,3
10 bis 49 Beschäftigte	1043	12,5
50 bis 99 Beschäftigte	757	9,0
100 bis 499 Beschäftigte	2023	24,2
500 bis 999 Beschäftigte	759	9,1
1000 und mehr Beschäftigte	2431	29,0
	8374	100,0

Betriebliche Funktion

	Exemplare	%
Unternehmensleitung	565	6,7
Techn. Management	1992	23,5
Forschung/Entwicklung	2133	25,5
Konstruktion	671	8,0
Fertigung	1705	20,4
Qualitätskontrolle, Test	538	6,4
Verkauf	345	4,1
Marketing / Werbung	339	4,1
Studenten	46	0,5
Hochschulen/Sonstige	39	0,5
	8374	100,0

Zeitschriftenformat: DIN A4 210 breit x 297 hoch mm
Anschnitt 216 breit x 303 hoch mm

Satzspiegel: 185 breit x 260 hoch mm

Anzeigenformate und Grundpreise: Preise in Euro

Format bei Anzeigen pro Jahr	Breite x Höhe	Maße mit Anschnitt	Preise für 4-Farbdruck				
			1x	2x	4x	6x	8x
1/1- Seite	185 x 260	216 x 303	4.780,00	4.541,00	4.302,00	4.063,00	3.824,00
2/3- Seite	123 x 260 oder 185 x 173	129 x 303	3.700,00	3.515,00	3.330,00	3.145,00	2.960,00
1/2 Juniorpage	135 x 195	138 x 198	3.260,00	3.097,00	2.934,00	2.771,00	2.608,00
1/2- Seite	93 x 260 oder 185 x 130	96 x 303 oder 216 x 133	2.900,00	2.755,00	2.610,00	2.465,00	2.320,00
1/3- Seite	62 x 260 oder 185 x 87	65 x 303 oder 216 x 90	2.420,00	2.299,00	2.178,00	2.057,00	1.936,00
1/4- Seite	46 x 260 oder 185 x 62 oder 93 x 130	96 x 133 oder 216 x 65 oder 49 x 303	1.740,00	1.653,00	1.566,00	1.479,00	1.392,00
1/8- Seite	46 x 130 oder 93 x 62 oder 185 x 33	49 x 133 oder 96 x 65 oder 216 x 36	900,00	855,00	810,00	765,00	720,00
1/16-Seite	46 x 62 oder 93 x 31		480,00	460,00	420,00	410,00	390,00

Preise für Vorzugsplätze: 2., 3. und 4. Umschlagseite +15%

Sonstige Platzierungsvorschrift: +10% auf den Grundpreis

Anschnittzuschläge werden **nicht** berechnet

Gelegenheitsanzeigen und Stellenangebote

Je mm bei einer Spaltenbreite von 42 mm € 4,00

Bankverbindung:

Jost Dennier Mainzer Volksbank Kto.-Nr.: 787 587 013 BLZ: 551 900 00
BIC-Code: MVBMD55 IBAN: DE83 5519 0000 0787 5870 13

Einhefter/Einkleber:

Papiergewicht: 80 bis 120 g/m²

2 Seiten (nur Einkleber)	4 Seiten	6 Seiten	8 Seiten
3 450,00	4 990,00	6 610,00	8 240,00

Beilagen: Teilbeilagen sind möglich

bis 25 g/1000 inkl. Porto 290,00	bis 50 g/1000 inkl. Porto 390,00
-------------------------------------	-------------------------------------

Druckverfahren: Offset

Druckunterlagen: PDF-Dateien als Druckunterlagen werden bevorzugt.

Versandanschrift: SMT-Verlag, Oberer Schenkgarten 1,
D-55218 Ingelheim, Tel: 06132 431647, Fax: 06132 431649,
E-Mail: info@smt-verlag.de

Aufträge gemäß den Standard-Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Fachzeitschriften.

Termine	Themen SMT	Themen CADS	Themen EMV-ESD	Messen
Ausgabe 1 mit CADS 1 Redaktionsschluss 02.02.2023 Anzeigenschluss 08.02.2023 Erscheinungstermin 17.02.2023	Packaging, Lötverfahren, Bestückung Sieb-/Schablonendruck AOI, AXI, Flying Prober	Design, Verifikation, Platzieren, Entflechten, Signalintegrität ASIC, FPGA, PLA		APEX 24. - 26.01.2023 San Diego
Ausgabe 2 mit EMV-ESD 1 Redaktionsschluss 07.03.2023 Anzeigenschluss 14.03.2023 Erscheinungstermin 21.03.2023	Vorberichte » SMTconnect « Packaging, Chip-on-Board, Rework, Bestücktechnik, Schablonendruck Testsysteme, Lötssysteme Schwerpunktthema: Reparatur/Rework		Vorschau EMV 2023 Störfestigkeit Messtechnik Antennen Filter, Stromversorgung ESD, Produktsicherheit	EMV 28. - 30.03.2023 Stuttgart Hannover Messe 17. - 21.04.2023 Hannover
Ausgabe 3 mit EMV-ESD 2 Messeheft SMTconnect 2023 Redaktionsschluss 12.04.2023 Anzeigenschluss 20.04.2023 Erscheinungstermin 03.05.2023	Vorberichte » SMTconnect « Reparatur/Rework, Löttechnik, Bonden, CSP, Flip Chip, Wafer, Reinraumtechnik, Halbleitertest, AOI Schwerpunktthema: Baugruppentest		Messtechnik Filter, Stromversorgung Stromversorgung Produktsicherheit	SMTconnect 09. - 11.05.2023 Nürnberg Intersolar Europe 14.06. - 16.06.2023 München
Ausgabe 4 mit EMV-ESD 3 Redaktionsschluss 05.07.2023 Anzeigenschluss 12.07.2023 Erscheinungstermin 20.07.2023	Löttechnik, Bestücktechnik Packaging, Underfill, Bonding Testautomation, Boundary Scan Marktübersicht: Schablonendrucker		Laboreinrichtungen ESD, Überspannung Störfestigkeit Antennen, Messtechnik	parts2clean 26. - 28.09.2023 Stuttgart
Ausgabe 5 mit CADS 2 Redaktionsschluss 06.09.2023 Anzeigenschluss 14.09.2023 Erscheinungstermin 27.09.2023	Vorberichte » productronica « Löttechnik, Selektivlöten Dispensen, Bestückung MCM, Board-Test, ICT, AOI, AXI Marktübersicht: Bestückssysteme	Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität Logische Designverifikation		Motek 10. - 13.10. 2023 Stuttgart
Ausgabe 6 mit EMV-ESD 4 MESSEHEFT »productronica 2023« Redaktionsschluss 12.10.2023 Anzeigenschluss 26.10.2023 Erscheinungstermin 02.11.2023	Vorberichte » productronica « Packaging, Bestückung, Leiterplattenfertigung, Schablonendruck, Löttechnik Schwerpunktthema: Steckverbinder		Messtechnik Antistatische Materialien Dienstleistungen Störfestigkeit Produktsicherheit	Semicon Europe 14. - 17.11.2023 München productronica 14. - 17.11.2023 München SPS/IPC/DRIVES 14. - 16.11.2023 Nürnberg